

MEXTAGE

第56期 株主通信

2024年1月1日から2024年12月31日まで

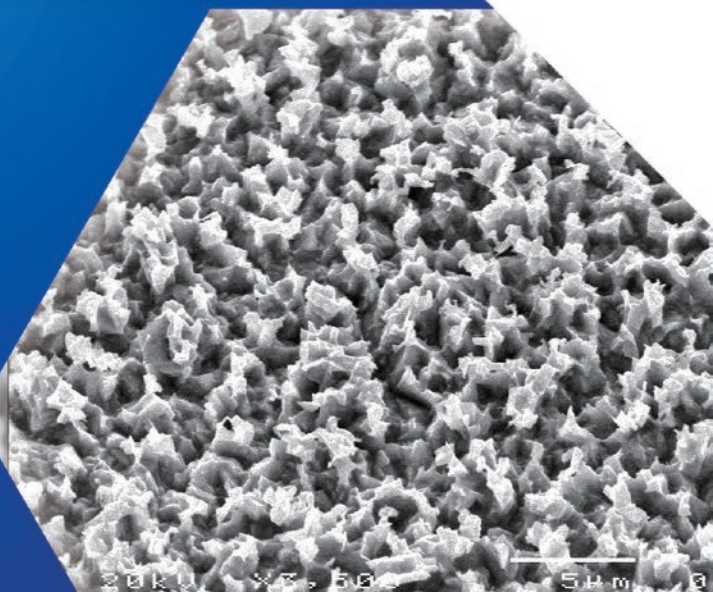
- P.1 2024年度の業績振り返りと
今後の事業戦略
- P.3 2024年度の業績を教えてください
- P.4 TOPICS
中期経営計画
- P.5 財務指標
- P.6 会社概要、株式の状況

社是

仕事を楽しむ

経営理念

わたしたちは「独創の技術」「信頼の品質」
「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、
グローバルな事業活動を通して界面価値創造
を実現することで豊かで潤いのある社会と
環境づくりに貢献します。



2024年度の業績振り返りと 今後の事業戦略



コア技術による市場拡大と 新技術領域の開拓へ

代表取締役社長

前田和夫

■ 生成AIの牽引等で全般に回復基調に

当期の世界経済は、欧米諸国を中心とした金融引き締めが緩和に向かう一方、減速する中国経済や米国の政権交代による政策変更の可能性、長期化するウクライナ情勢や緊迫する中東情勢など、地政学リスク上昇に伴う先行き懸念のもとで推移しましたが、わが国経済においては一部足踏み状態が見られたものの、緩やかな回復傾向となりました。

このような情勢のもと、半導体市場およびエレクトロニクス業界では、生成AI関連が牽引して先端分野への投資が堅調さを維持し、AI用途以外の需要も期後半には緩やかな回復基調となりました。自動運転への技術転換が進む車載関連については、地域による濃淡は見られたものの概ね堅調に推移。在庫調整が一巡したと見られるパソコンやスマートフォンも緩やかな回復基調にありましたが、勢いに力強さを欠きました。

これらの影響を受けて主要製品の売り上げ動向は、在庫調整局面にあった前期と比較して増加に転じ、当期売上高は過去最高となりました。営業利益面でも薬品生産量の増加や生産効率の改善等により大幅な増益でしたが、当期純利益は、2030年目指すべき企業像に向けたグループ再編に伴う海外連結子会社（メック香港）の解散および清算の影響もあって前期比で減少しました。

■ 主力製品「CZシリーズ」は大幅増

半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、生成AI関連など先端パッケージ基板向け製品需要が拡大しました。一方、汎用サーバーやパソコン向け製品など従来分野における需要についても、力強さを欠いたものの回復基調に転じたことなどから、総じて大幅な増加となりました。

■ 「EXE・SFシリーズ」増加、「V-Bondシリーズ」堅調

ディスプレイ向けエッチング剤「EXEシリーズ」は、TVを主としたディスプレイ搭載のCOF*向けの在庫調整が一巡したことにより、需要回復が見られ増加しました。ディスプレイ向け選択エッチング剤「SFシリーズ」も、タブレットPC等関連する電子機器の生産動向を受けて増加、多層電子基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は、車載基板向けや衛星関連基板向けに堅調に推移しました。

■ 中期経営計画Phase2の重点課題について

当社グループが策定した中期経営計画 Phase2（2025年度～2027年度）の事業分野における重点課題に「新技術での地位確立」と「既存技術を応用した事業構築」の2つを挙げています。1つめの重点課題では「化学密着」に注力しています。これは銅表面を物理的に粗化せず樹脂との密着を図る「無粗化」技術で、AIサーバーや5Gなどの高速通信ネットワーク分野では信号伝送損失が課題ですが、無粗化であれば電気信号が機器内の回路を効率的に流れ、大容量データのさらなる高速処理と消費電力低減が可能になります。当社は先端パッケージ基板の分野で「化学密着」をデファクトスタンダードにすべく取り組んでおり、高周波基板やPCB基板においても同技術を展開、拡大する方針です。

2つめの重点課題では、化学密着、選択エッチング、粗化などの当社コア技術を応用展開して、例えば、半導体により近い分野を開拓していこうと考えています。これらの課題に取り組み、成果を挙げることで、中期経営計画 Phase2で掲げる数値目標の達成を目指してまいります。



詳細はホームページ掲載の決算短信をご覧ください。

www.mec-co.com/ir/library/

注目する半導体パッケージ技術領域

半導体パッケージの高機能化、高速化に伴い、半導体チップの高集積化を図るパッケージ技術が開発されています。その中でも半導体チップと基板の間に配置される中間層に使用されているインターポーザーに注目しています。インターポーザーは高密度の配線を可能にする重要な役割を果たしており当社のコア技術が十分に活かせる領域でもありますので、今後の積極展開を図ります。

当社連結子会社(メック香港)の解散理由

1996年3月に中国向け販売拠点として設立したメック香港(MEC(HONG KONG)LTD.)は、2002年12月に販売・製造機能を持つ子会社 MEC FINE CHEMICAL(ZHUHAI)LTD.(中国広東省珠海市、現当社連結子会社)を設立後、販売活動の縮小が続いていました。そうした経緯からグループ全体の事業の合理性や経営効率を勘案し、2024年10月の当社取締役会において当該会社の解散及び清算を決定しました。

次期見通しと配当政策

次期につきましては、引き続き生成AI関連向け先端パッケージ基板の需要拡大や、パソコンや汎用サーバーの本格的な回復を見込んでいます。配当につきましては、連結年間配当を一株当たり55円とし、従来どおり安定配当を基本に連結配当性向30%を目標においております。

株主の皆様へのメッセージ

当社を取り巻く経営環境は日々大きく変動していますが、世界のエレクトロニクス業界においては、生成AIや自動運転、DXなどの進展に向けた半導体需要を伴うメガトレンドは継続しており、当面その傾向は変わらないと考えています。その中で当社は半導体先端パッケージ基板の分野にコア技術を提供し、AIの精度向上や低消費電力化、高性能化に貢献して事業拡大に取り組むとともに、高速・情報通信分野で新技術領域を開拓することで持続的成長を目指してまいります。今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

用語解説

■ COF (Chip On Film)

フィルム状基板に直接半導体チップを搭載する実装技術



2024年度のポイント

押さえておきたい2024年度のポイントを2ポイントにまとめています。

1

先端分野への投資が堅調で、
当期売上高は過去最高に

2

「CZシリーズ」はじめ
全主要製品が増加



2024年度の実績

	2023年 12月期 2023年1月1日～ 2023年12月31日	2024年 12月期 2024年1月1日～ 2024年12月31日	増減
売上高 (百万円)	14,020	18,234	30.1% 増
営業利益 (百万円)	2,492	4,562	83.0% 増
経常利益 (百万円)	2,683	4,682	74.5% 増
親会社株主に 帰属する当期 純利益 (百万円)	2,304	2,291	0.6% 減
1株当たり 当期純利益 (円)	122.29	122.38	

当社の主要薬品を紹介

密着向上剤

■ CZシリーズ

パッケージ基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用する薬品
(最終製品例：パソコン、スマートフォン、データセンター等)

■ V-Bondシリーズ

多層基板向けに、銅樹脂間の密着性を高める用途で使用する薬品
(最終製品例：車、スマートフォン、衛星通信等)

エッチング剤

■ EXEシリーズ

COF (Chip on Film) 基板向けに、不要な銅を溶かし微細配線を形成する用途で使用する薬品
(最終製品例：テレビ、パソコンのモニター等)

■ SFシリーズ

銅を選択的に溶かす用途で使用する薬品
(最終製品例：タブレットPC等)

業績推移および製品別・セグメント別 販売動向について

Q 当期の事業環境と業績について 教えてください

A 回復基調のもとで過去最高の売上高に

当社グループの関連市場である電子基板・部品業界は、エレクトロニクス業界の影響を受け、回復基調に転じる動きが見られ、概ね堅調に推移しました。データセンターにおいては生成AI関連が牽引役となり先端分野への投資が堅調、汎用サーバーの需要も年後半には回復基調に。車載関連は概ね堅調で、パソコンやスマートフォンは緩やかな回復基調で推移しました。

このような環境のもと、当社グループは「Phase 1 中期経営計画（2022年度～2024年度）」を達成するため「創造と改革」を指針に事業活動に取り組み、高密度電子基板向け製品の開発、販売に注力いたしました。

主要製品の売上動向としましては、半導体を搭載するパッケージ基板向けに高いシェアを持つ超粗化系密着向上剤「CZシリーズ」は、生成AI関連など先端パッケージ基板向け製品需要の拡大、汎用サーバーやパソコン向け製品の需要が回復基調にあることなどを受け大きく増加し、ディスプレイ向け「EXEシリーズ」も、関連する電子機器の在庫調整一巡により当社製品の需要が回復し増加しました。ディスプレイ向け「SFシリーズ」は、関連する電子機器の生産動向を受け増加、多層基板向け密着向上剤「V-Bondシリーズ」は、車載基板や衛星関連基板向けで堅調に推移しました。

その結果、当期の売上高は182億34百万円（前期比30.1%増）、営業利益は45億62百万円（同83.0%増）、売上高営業利益率は25.0%（同7.2ポイント増）、経常利益は46億82百万円（同74.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は22億91百万円（同0.6%減）となりました。

Q 製品別の販売状況を教えてください

A 全般に前期比で売上増に

「CZシリーズ」の売上高は113億6百万円（前期比31.0%増）、薬品売上高に占める割合は64.7%（同2.0ポイント増）となりました。「EXEシリーズ」は13億67百万円（同22.5%増）、「V-Bondシリーズ」は8億34百万円（同11.8%増）、「SFシリーズ」は6億53百万円（同19.6%増）となりました。

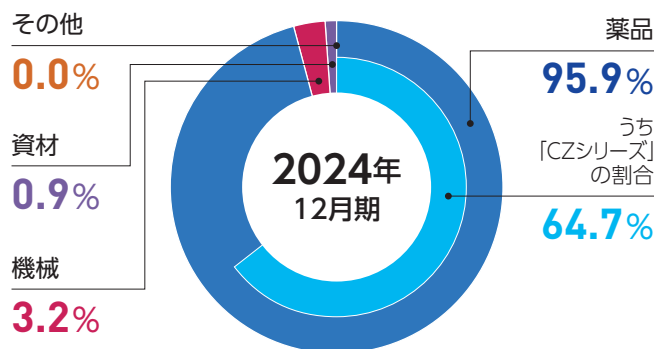
Q 地域別の販売動向はどうでしたか？

A 国内は概ね復調、海外は全般に売上増

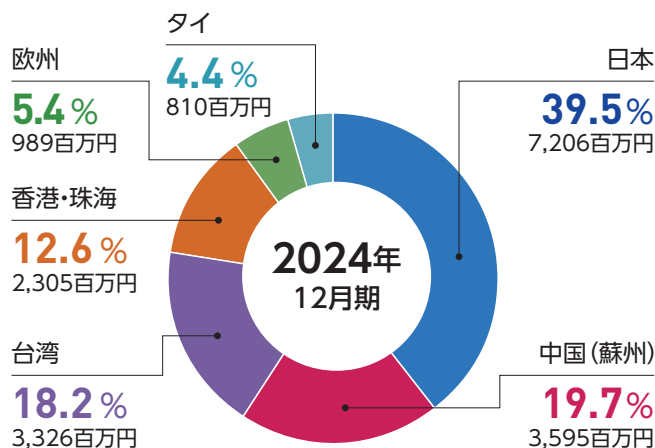
地域別売上高（連結）における海外売上高比率は61.7%（前期比0.3ポイント減）となりました。日本では、先端パッケージ向け製品需要が

拡大基調で、パソコン関連の製品需要は回復傾向が見られるも力強さに欠け、従来型サーバーの需要は復調。ディスプレイ向け薬品は当期前半堅調でしたが、後半は在庫調整の影響で減速しました。日本代理店経由で販売している韓国向けは、メモリ向けパッケージ基板は回復途上、ディスプレイ向け薬品は日本と同様に推移し、前期比で売上が増加。台湾はディスプレイ向け薬品が年後半に減速したものの、先端パッケージ基板の需要増加や従来型サーバー、スマートフォンの復調で売上増。香港（香港、珠海）も、スマートフォンや車載向け需要が回復基調で売上が増加しました。中国（蘇州）はスマートフォン関連の需要回復や当社主要顧客におけるパソコン需要の取り込みで売上増。欧州も顧客により濃淡はあるものの売上増に。タイでは、電子基板メーカーの東南アジアにおける設備投資が活発化する中、当社主要顧客における製品需要が拡大し、売上は前期比で増加しました。

売上高に占める品目別割合（%）



地域セグメント別売上高比率（%）／売上高（百万円）

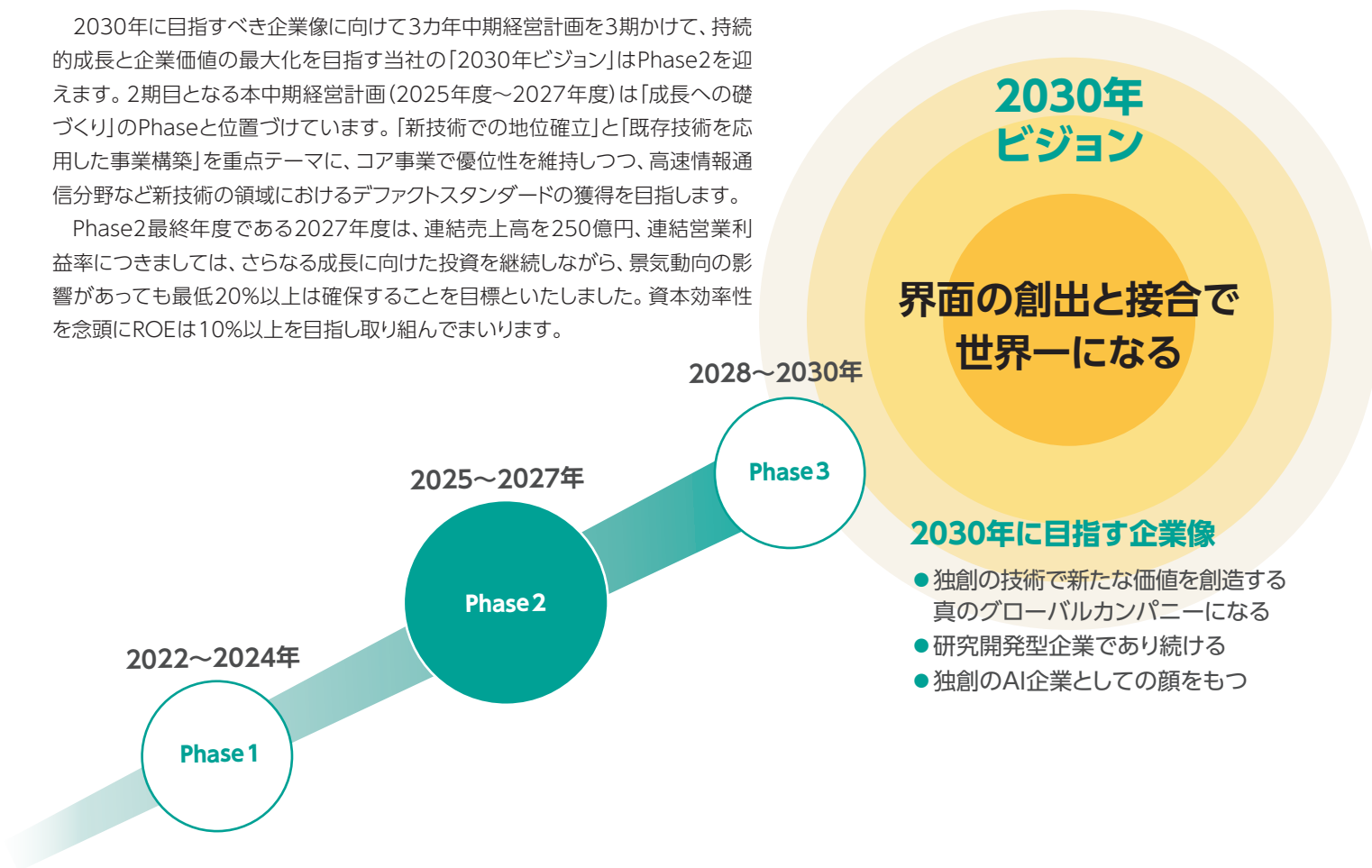


* 比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

2030年に目指すべき企業像に向けて 「成長への礎づくり」に取り組みます

2030年に目指すべき企業像に向けて3カ年中期経営計画を3期かけて、持続的成長と企業価値の最大化を目指す当社の「2030年ビジョン」はPhase2を迎えます。2期目となる本中期経営計画(2025年度～2027年度)は「成長への礎づくり」のPhaseと位置づけています。「新技術での地位確立」と「既存技術を応用した事業構築」を重点テーマに、コア事業で優位性を維持しつつ、高速情報通信分野など新技術の領域におけるデファクトスタンダードの獲得を目指します。

Phase2最終年度である2027年度は、連結売上高を250億円、連結営業利益率につきましては、さらなる成長に向けた投資を継続しながら、景気動向の影響があっても最低20%以上は確保することを目標といたしました。資本効率性を念頭にROEは10%以上を目指し取り組んでまいります。



Phase2

定量目標

連結売上高 **250** 億円

連結営業利益率 **20%** 以上

ROE **10%** 以上

定性目標

既存市場における収益性維持・強化

- 顧客との関係性強化
- 超微粗化系密着向上処理のシェア維持
- 無粗化技術(化学密着)領域におけるソリューション確立
- 環境配慮薬品への取り組み

既存技術の応用展開分野における事業構築

新規事業の創出

グローバル安定供給体制の確立

ESG経営の推進・強化

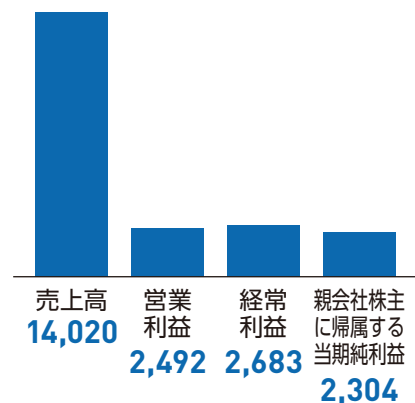




連結損益計算書の概要 (百万円)

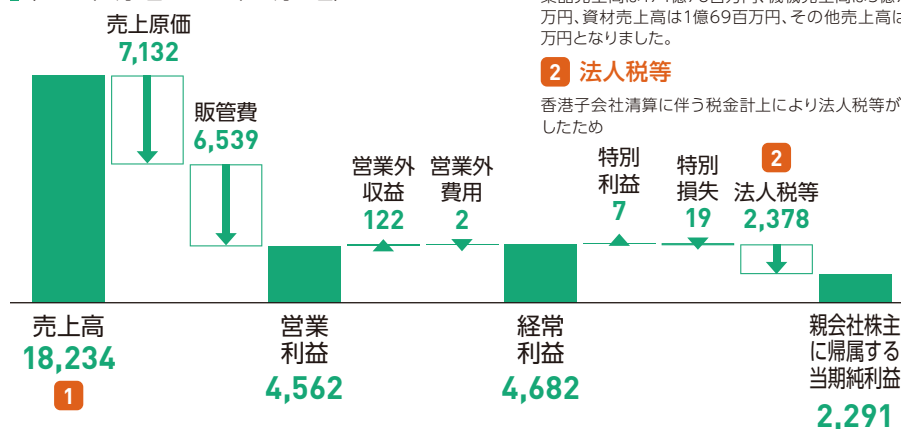
2023年12月期

(2023年1月1日～2023年12月31日)



2024年12月期

(2024年1月1日～2024年12月31日)



1 売上高

薬品売上高は174億78百万円、機械売上高は5億79百万円、資材売上高は1億69百万円、その他売上高は7百万円となりました。

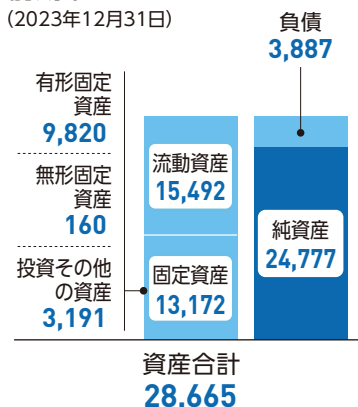
2 法人税等

香港子会社清算に伴う税金計上により法人税等が増加したため

連結貸借対照表の概要 (百万円)

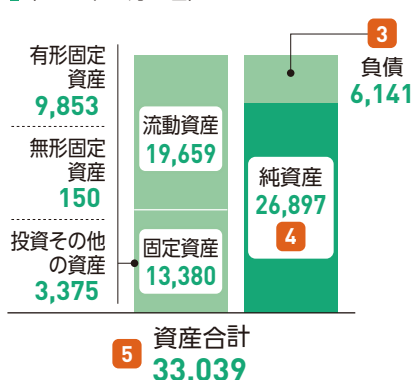
前期末

(2023年12月31日)



2024年12月期

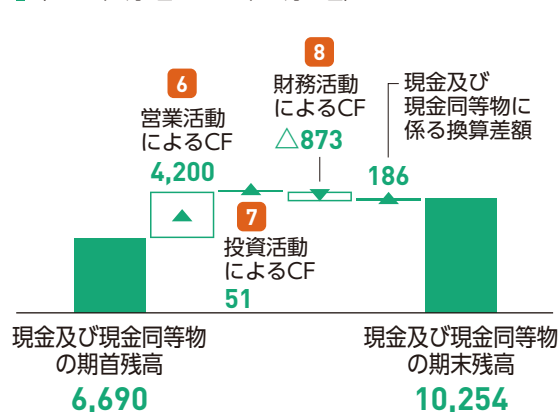
(2024年12月31日)



連結キャッシュ・フロー計算書の概要 (百万円)

2024年12月期

(2024年1月1日～2024年12月31日)



3 負債

負債は、未払法人税や長期繰延税金負債等の増加等により、22億54百万円増加し、61億41百万円となりました。

4 純資産

純資産は、利益剰余金の増加等により、21億19百万円増加し、268億97百万円となりました。

5 資産合計

資産は、現金及び預金や売上債権の増加等により、43億73百万円増加し、330億39百万円となりました。

6 営業活動によるCF

営業活動の結果得られた資金は、42億円。これは主に税金等調整前当期純利益が46億69百万円、減価償却費が8億16百万円、法人税等の支払額が9億50百万円計上されたこと等によるもの。

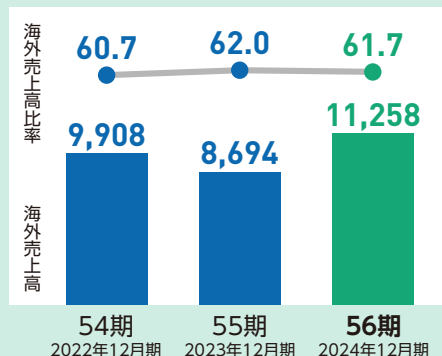
7 投資活動によるCF

投資活動の結果得られた資金は、51百万円。これは主に有形固定資産の取得による支出が7億29百万円、投資有価証券の売却による収入が1億円、定期預金の払戻しによる収入が純額で9億71百万円計上されたこと等によるもの。

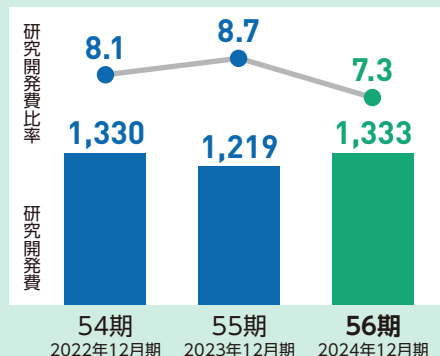
8 財務活動によるCF

財務活動の結果使用した資金は、8億73百万円。これは主に配当金の支払が8億49百万円計上されたこと等によるもの。

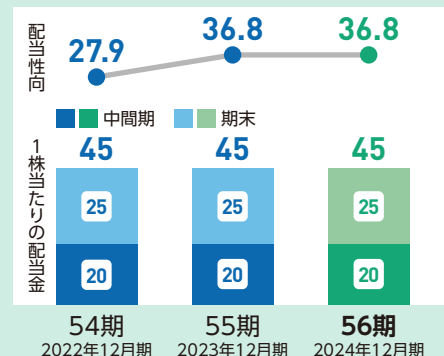
海外売上高(百万円)／比率(%)



研究開発費(百万円)／比率(%)



1株当たりの配当金(円)／配当性向(%)



会社概要

■ 2024年12月31日現在



会社概要

商号 メック株式会社
本社事務所所在地 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
設立年月日 1969年(昭和44年)5月1日
資本金 594,142,400円
事業内容 電子基板・部品製造用薬品の製造販売
および機械装置、各種資材の販売

取締役および執行役員

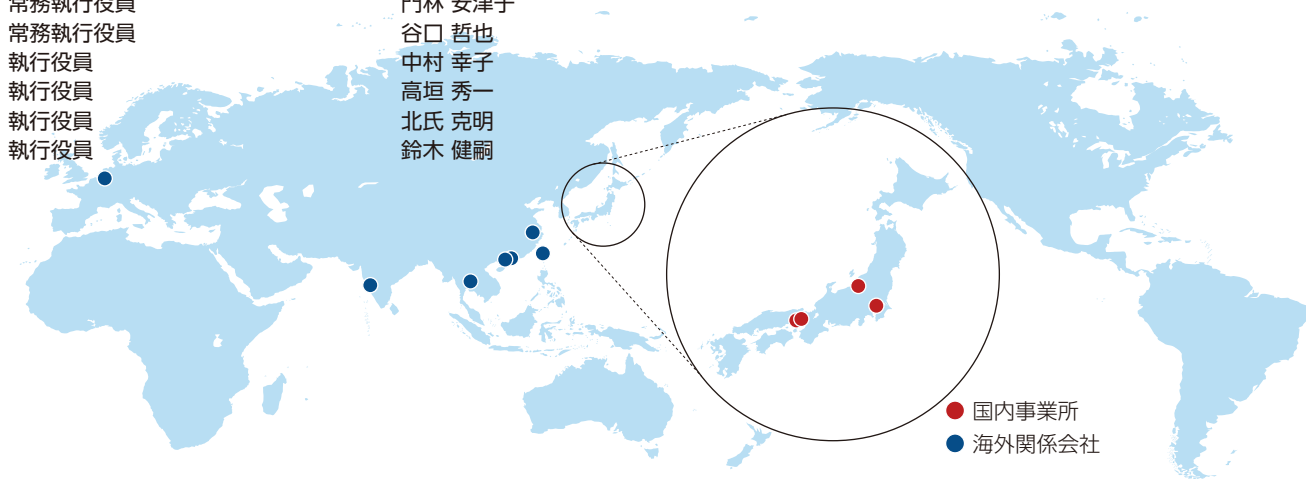
代表取締役社長	前田 和夫
取締役常務執行役員	中川 登志子
取締役常務執行役員	住友 貞光
取締役(社外)	北條 俊彦
取締役 監査等委員会委員長(社外)	高尾 光俊
取締役 監査等委員(社外)	橋本 薫
取締役 監査等委員(社外)	宮下 英二
常務執行役員	門林 安津子
常務執行役員	谷口 哲也
執行役員	中村 幸子
執行役員	高垣 秀一
執行役員	北氏 克明
執行役員	鈴木 健嗣

国内事業所

本社・尼崎事業所
本社・東初島事業所
東京営業所
長岡工場

海外拠点

MEC TAIWAN COMPANY LTD.
MEC EUROPE NV.
MEC (HONG KONG) LTD.
MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.
MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.
MEC SPECIALTY CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.
MEC INDIA SPECIALTY CHEMICALS PRIVATE LTD.



株式の状況

■ 2024年12月31日現在

株主状況

発行済株式総数 **20,071,093 株**
株主数 **12,508 名**

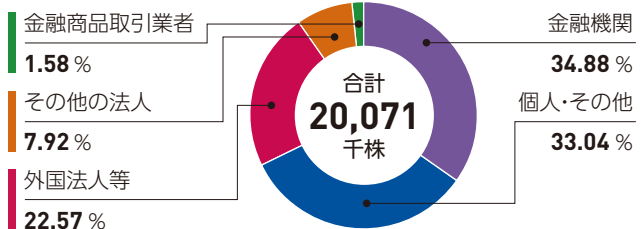
大株主の状況

株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3,075	16.28
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,351	12.44
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	1,540	8.15
株式会社マエダホールディングス	1,199	6.34
前田和夫	726	3.84
前田耕作	555	2.93
メック取引先持株会	551	2.91
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	534	2.83
野村信託銀行株式会社(投信口)	526	2.78
住友生命保険相互会社	402	2.13

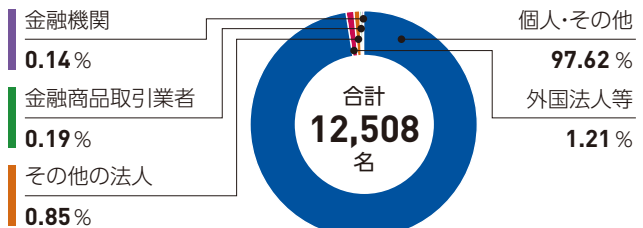
※当社は自己株式を1,181千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※持株比率は、自己株式を除く発行済株式の総数に対する比率です。

株式分布状況

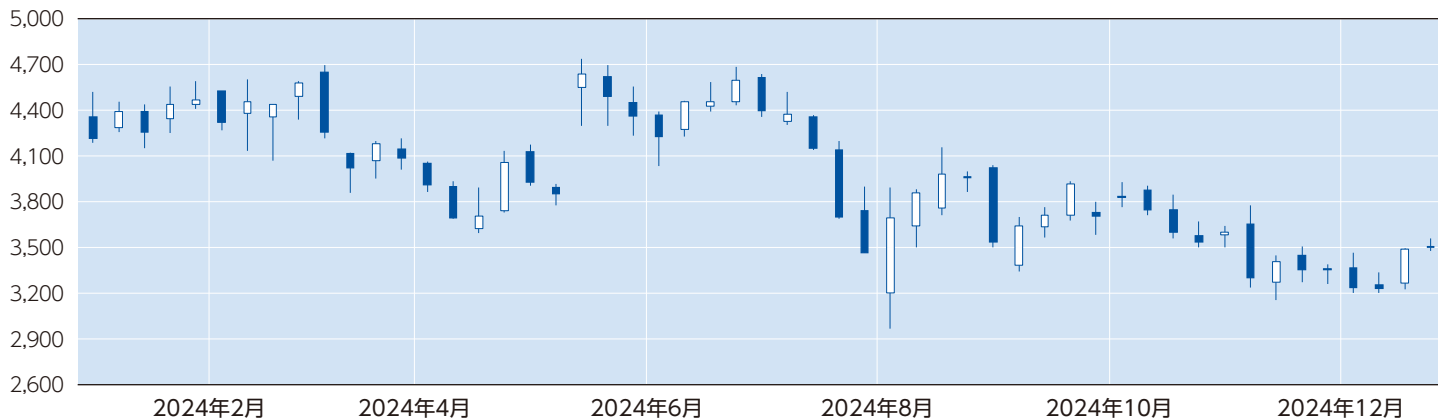
所有者別所有株式数



所有者別株主数



※「個人・その他」には自己株式1,181千株を含んでおります。
※比率は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。



株主メモ

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで
期末配当金 受領株主確定日	毎年12月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年6月30日
定時株主総会	毎年3月
単元株式数	100株
株主名簿管理人 および特別口座 の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株式名簿管理人 事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先※	TEL. 0120-782-031 (通話料無料) 受付時間 9:00～17:00 (土日休日を除く)
インターネット ホームページURL	www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
上場証券取引所	東京証券取引所プライム市場
証券コード	4971
公告の方法	電子公告により行う。 公告掲載URL www.mec-co.com/ir/denshi/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。)

株主優待情報

保有株式数	優待内容	
1,000株未満	QUOカード 1,000円分	*毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主様を対象といたします。
1,000株以上	QUOカード 2,000円分	

株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会

- 証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先※までご連絡ください。

ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者の皆様にそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。
ご希望の株主様には、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、当社ホームページまたは、RIMSNET(rims.tr.mufig.jp/)から、簡単にご登録いただけます(無料)。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆様とのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めていきたいと考えています。
つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。
※ご提供いただきました情報は、本アンケートの集計の目的以外に使用することはありません。

ホームページのご紹介

www.mec-co.com/

当社のホームページではプレスリリース、株主通信、サステナビリティ報告書、コーポレート・ガバナンス報告書 他各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください。



メック株式会社

本社・尼崎事業所/〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町三丁目4番1号
TEL. 06-6401-8160 FAX. 06-6401-8165

URL www.mec-co.com/

